# ガラスのレーザ割断に関する研究

# 金沢大学大学院 藤江典久,有川龍郎,上田隆司,細川晃,古本達明,田中隆太郎

Study on the laser cleaving of glass materials

Kanazawa University Graduate School of Natural Science and Technology Norihisa Fujie, Taturou Arikawa, Takasi Ueda, Akira Hosokawa, Tatsuaki Furumoto, Ryutaro Tanaka

Laser cleaving is a prospective technique for separating a wafer or thin plate from brittle materials such as glasses and ceramics. However, there is a problem that laser irradiation often causes the thermal damage. Thermal damage to the surface of the glass causes the deterioration of cleaving accuracy. Consequently, it is important to minimize the thermal damage. In this paper, new cleaving technique in which both CO<sub>2</sub> laser and Er:YAG lasers are used at the same time is examined to prevent the thermal damages.

## 1.緒 言

近年,セラミックスやガラス等の脆性材料の分断法として,従来のダイヤモンドブレードダイシングに比べて切り 代が小さく,清浄な加工が可能なレーザ熱応力割断が注目 を集めている.しかしながら,レーザ照射に伴う温度上昇 によって,加工物に副き裂やはく離が生じるなどの熱的影響が問題となっている.

そこで本研究では,CO<sub>2</sub>レーザ光を単独で照射した場合, CO<sub>2</sub>レーザ光とEr:YAGレーザ光の2つのレーザ光を同時に 照射した場合について,ガラスを割断する方法を提案する と共に,熱的影響抑制の効果について検討する.

#### 2. 熱応力割断の原理

レーザ光を加工物に照射すると,照射部は急激に温度が 上昇して,熱膨張する.これにより,レーザ照射部には圧 縮応力場が,その周辺部分にはこれと釣合うように引張応 力場が発生する.この引張応力場では応力が円周方向に働 くため,その内部にき裂の先端が位置する場合,き裂が照 射部中心に向かって進展することとなる.したがって, レーザ照射部を移動させながらき裂の進展を追従させるこ とで,材料の分断が可能となる.

今回提案している方法は, CO<sub>2</sub> レーザ光と Er: YAG レーザ 光を同時に照射するもので, Er: YAG レーザ光を材料内部の 加熱源として, CO<sub>2</sub> レーザ光を応力場発生源として用いて いる.



Fig.1 Experimental set up



Specimen:	Soda lime glass
Installation of pre-clack:	Vickers indenter
Feed rate : (mm/s)	1~5
Size:	20×40
Thickness: (mm)	1.3~5

# 3. CO2 レーザを用いた割断実験

3.1 実験方法 ガラスのレーザ割断において,応力場の発 生源として用いる CO<sub>2</sub> レーザは,ガラスに対する吸収率が 大きく,照射スポット径が割断の可否や性能に大きく影響 を及ぼすことが考えられる.

そこで本実験では,デフォーカス量を変化させて照射ス ポット径を変え,その違いが割断結果に及ぼす影響につい て検討した.

実験条件及び試料を表1,表2に示す.試料は,厚さが 1.3 ~ 5mmのソーダ石灰ガラスを用いる.試料端には,ビッ カース圧子を用いてあらかじめ初期き裂を導入している. 実験装置概略図を図1に示す.試料は,片もちの加工物保 持台に固定され,試料端よりレーザ光を照射し,一定の送 り速度を与え割断を行う.

3.2 実験結果 図2は,厚さが1.3mmの試料における割断 実験結果である.図より,デフォーカス量が大きくなるに つれて割断できる最小のパワーは次第に小さくなり,40mm から55mmのときで最小となり,その後また大きくなるこ とがわかる.



**Fig.2** Relationship between laser power Q and Defocus df(t=1.3mm)

Table2 Experimental	conditions
---------------------	------------

Laser:	Er:YAG laser	CO <sub>2</sub> laser
Wavelength : (µm)	2.94	10.6
Irradiation mode:	PW	CW
Pulse frequency: (Hz)	8	-
Defocus : (mm)	0	0~ 80
Laser power : (W)	8.8	4.5~13
Feed rate: (mm/s)	1~5	

そこで,割断に必要なレーザパワーが最小となったデフォーカス量40mmと55mmにおいて,それぞれ試料表面の観察を行い,熱的影響を調べた.その結果を図3に示す.図の写真は,分離した試料を0.5mm程度の隙間を空けて配し,それを上から撮影したものである.隙間以外で黒く観察されるのは,はく離した部分であり,デフォーカス量が55mmでは熱的影響がほとんど抑制できていることがわかる.

以上のことから,適切なデフォーカス量を設定すること で,割断するのに必要なレーザパワーを小さくすることが でき,熱的影響を抑制することができることがわかる.本 実験の結果を踏まえ,次章で設定するデフォーカス量を決 定する.



df=40mm df=55mm **Fig.3** Picture of specimen(V=5mm/s,Q=6W,t=1.3mm)

## 4.CO, レーザと Er: YAG レーザを用いた割断実験

4.1 実験方法 前章の結果から,薄板ガラスであれば, CO, レーザ光で熱損傷を抑制し割断することができること を示した.しかしながら厚板ガラスはCO、レーザ光のみを 用いた方法では熱的影響の抑制が困難であった.そこで本 実験では, CO, レーザ光と Er: YAG レーザ光の2つのレーザ 光を用いた割断方法を提案し, CO, レーザ光のみを用いた 結果と比較し,熱的影響抑制の効果について検討する.図 4に実験装置の概略図を示す.試料は,厚さが2~8mmの ソーダ石灰ガラスを用いた. 試料を片もちの加工物保持台 に固定し、一定の送り速度でステージを移動させ、CO。 レーザ光と Er: YAG レーザ光を加工物上に走査して割断を 行う.図4に示すように, Er: YAG レーザ光は垂直に, CO, レーザ光は反射鏡で角度を変え,デフォーカス量に応じて 54 °~ 57 °の方向から材料表面に照射する. 図5 に試料寸 法及び各レーザ光の照射位置関係を示す.試料には, Er:YAG レーザ光が先に照射され,その後 CO, レーザ光が照 射される.ガラスの試料端には,あらかじめビッカース圧 子を用いて初期き裂を導入している.実験条件を表2に示 す.

<u>4.2 実験結果</u> 図6はCO<sub>2</sub>レーザ光とEr:YAGレーザ光を 用いて割断したときの,試料厚さとレーザパワー,算術 平均粗さ,真直度の関係を示す.CO<sub>2</sub>レーザ光とEr:YAG レーザ光とを同時に用いた方はCO<sub>2</sub>レーザを単独で用い た方より,レーザパワー,真直度共に小さくなっている.

図7は,厚さが5mmの試料について照射面を観察した 結果である.

図より,CO<sub>2</sub>レーザ光を単独で用いた方は,はく離や副 き裂などが発生しているのに対し,CO<sub>2</sub>レーザ光と Er:YAGレーザ光とを同時に用いた方法では熱的影響を抑 制できていることがわかる.

#### 5. 結 言

(1) 薄板ガラスの場合, CO<sub>2</sub>レーザを用いる方法では,適切なデフォーカス量を設定することで,熱的影響を抑制 することが可能である.

(2) 厚板ガラスの場合, CO<sub>2</sub>レーザを用いる方法では熱的 影響抑制が困難であるが, CO<sub>2</sub>レーザとEr:YAG レーザと を同時に用いる方法で熱的影響を抑制し,真直度,粗さ の良好な結果を得ることができる.

謝辞:本研究に多大なご支援をしていただいた澁谷工業 (株)に対し記して謝意を表する.



Er:YAG laser:8.8W



